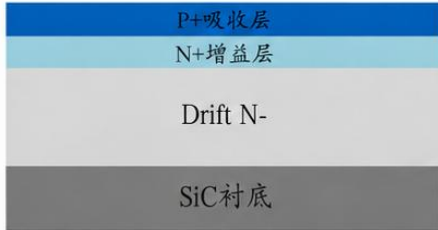


科创4

题目：1. 画出保护环终端的器件流程图 2. 画出刻蚀终端器件的光刻板



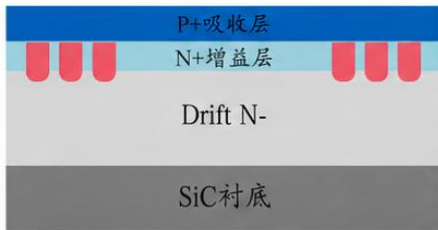
① 全外延结构



② 光刻形成保护环注入窗口



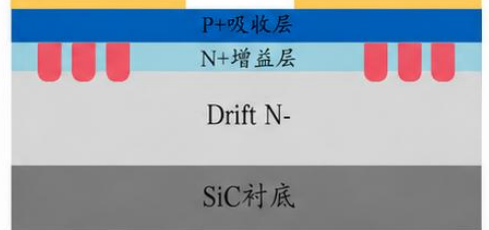
③ P+保护环离子注入



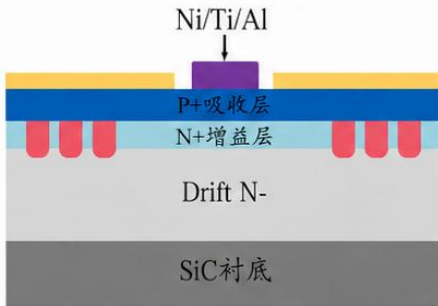
④ 去胶并高温退火激活



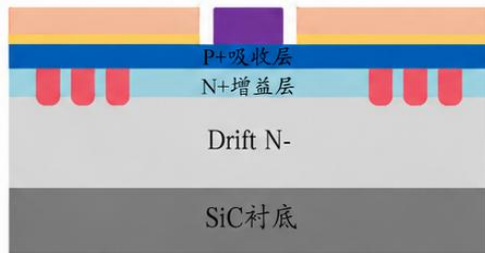
⑤ 热氧化或沉积钝化层



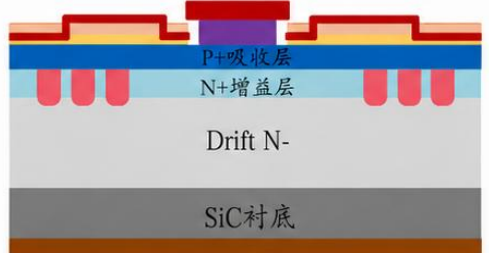
⑥ 刻蚀钝化层开接触窗口



⑦ 沉积接触金属电极



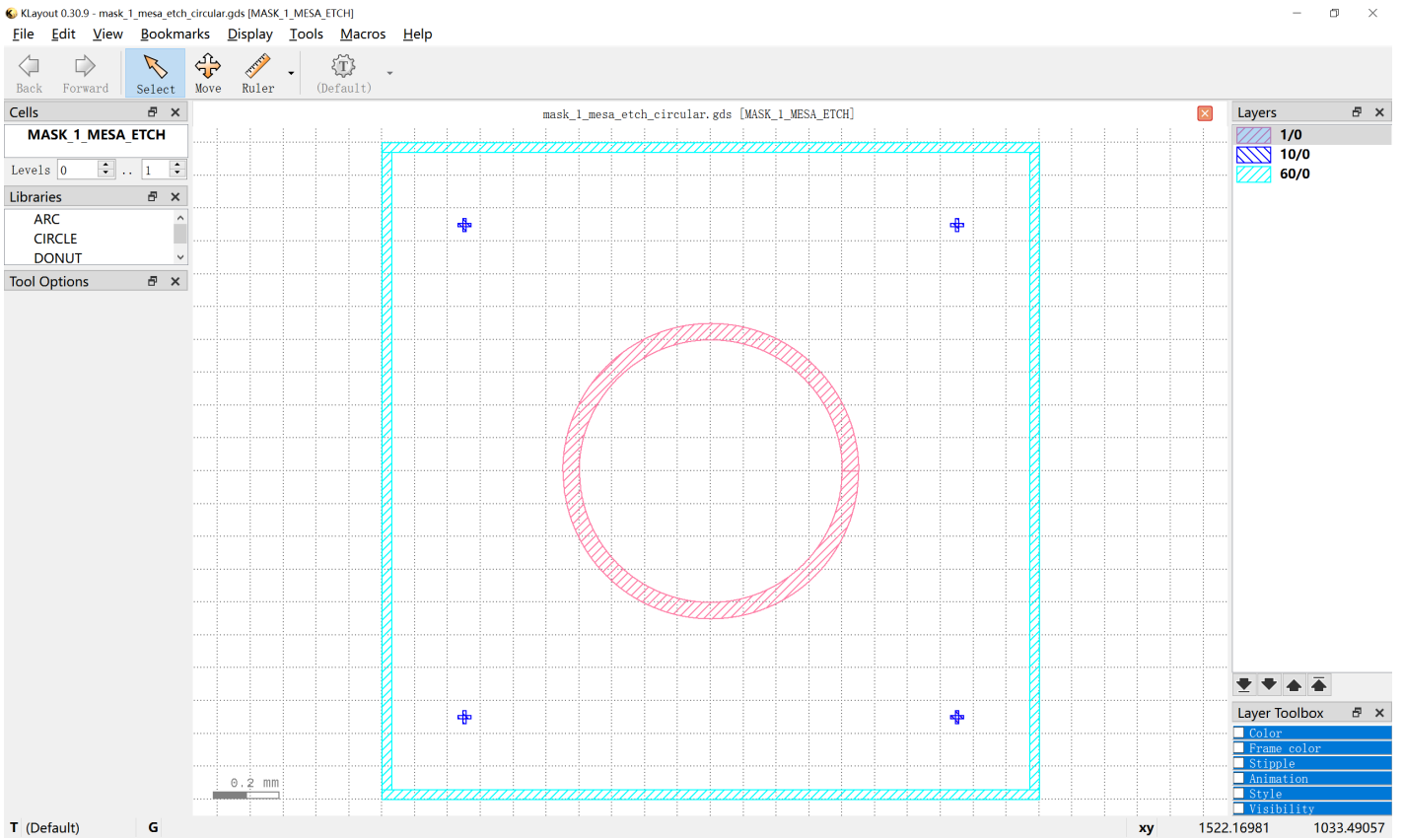
⑧ 再沉积钝化层并开PAD窗口



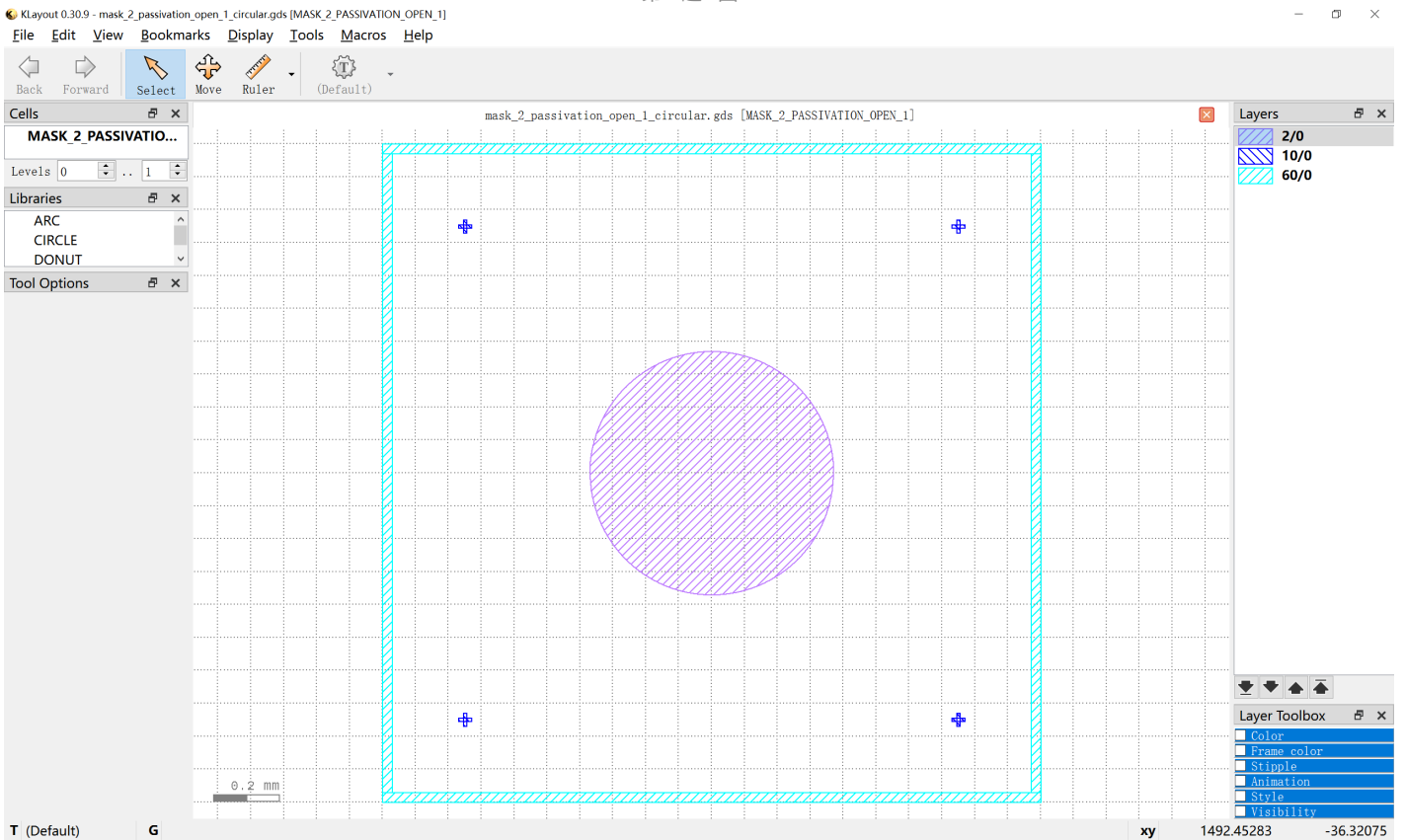
⑨ 沉积PAD金属和背面金属

第二题

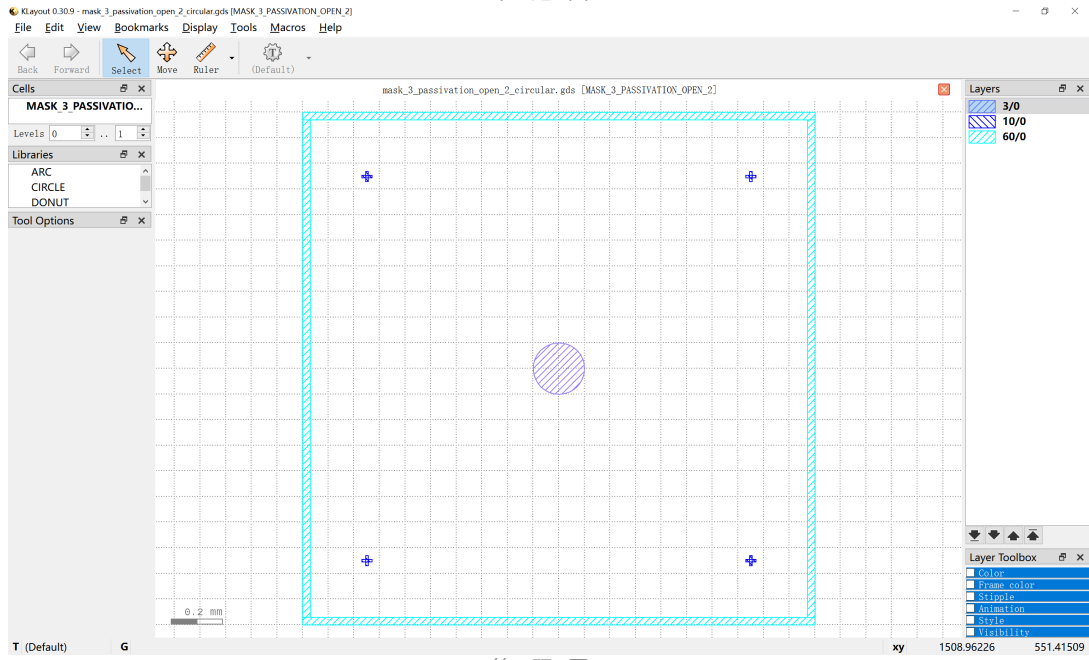
第二题·图 1



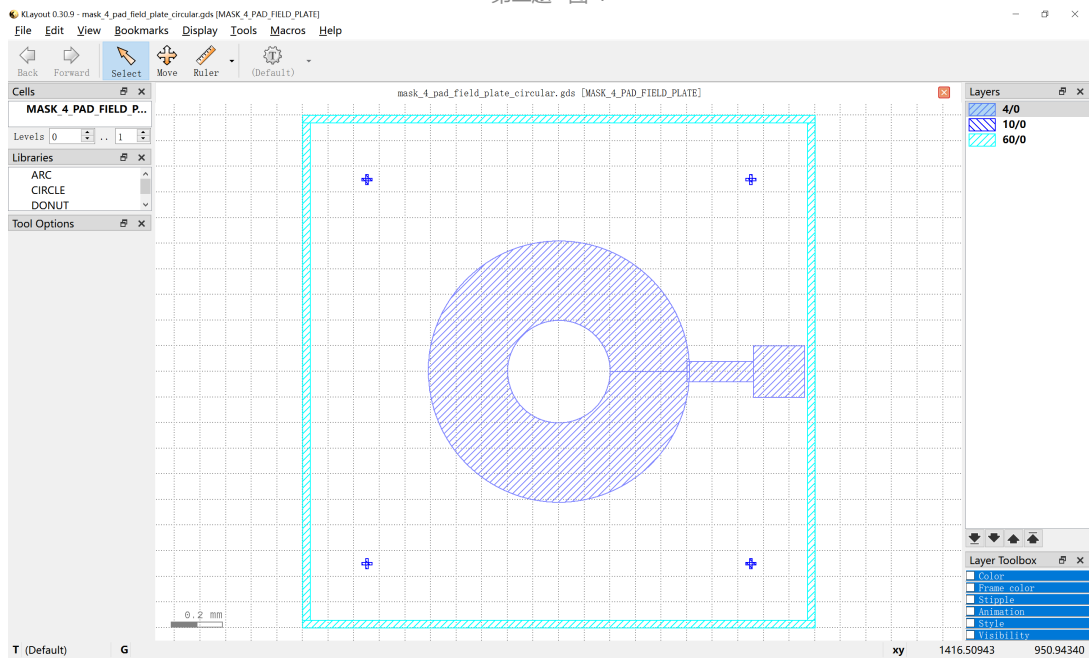
第二题·图 2



第二题 · 图 3



第二题 · 图 4



第二题 · 图 5

